

8 吋後段化學清洗蝕刻工作站 CF-C09

能力考核表

※ 防護器具之穿戴?

1. 防護器具是否確實穿戴?.....
2. 防護器具使用完畢, 是否依規定進行清潔、歸定位、擺放整齊.....

※ 設備危害認知及危機處理

1. 硫酸槽液體排放之溫度管制.....
2. B. O. E 槽排放之注意事項.....
3. 物質安全資料表(MSDS)之意義?.....
4. 各槽所能使用之化學品種類 (仔細說明硫酸槽之部份) 及危害認知?.....
5. 最臨近後段 wet bench 製程區之沖身洗眼器所在位置及如何正確使用?.....
6. 六氟靈及敵腐靈的使用方式?.....
7. 葡萄糖酸鈣的使用方法及使用時機?.....
8. 機台緊急狀況停機方法.....

※設備端污染管制相關規定及製程端污染管制原理

1. 後段 wet bench 製程區之專用貨架及晶舟之放置位為何?旋乾機的管制規定?.....
2. 破片能否在 wet bench 製程槽處理?若是其相關之乾燥設施為何?.....
3. 在 NDL 化學品使用之管制規定?(自行攜入或儲存暫放申請).....
4. 在後段製程區所使用所處理過之晶圓 (含破片) 能否再拿到前段製程 Bench 操作?.....

※各化學槽使用之基礎使用認知

1. 後段製程區中, 能在 H₂SO₄ 槽處理的金屬膜有那些?.....
2. 後段製程區中, 能在 B. O. E. 槽處理的金屬膜有那些?.....
3. B. O. E. 溶液能否以玻璃或石英 Tank 盛載浸泡之?為何?.....
4. 後段製程區中, 每一種允許被浸泡的溶液要如何汰換?(隨機取 1 種配方實作).....
5. Wet Bench 區之真空吸筆的使用?.....

※ 各種常用金屬膜移除或蝕刻製程之藥品汰換及配製藥品之流程操作.....

※ QDR 槽流程操作?

1. 在濕式清洗或蝕刻製程中, 一般都會使用 QDR 方式清洗晶圓, 何謂 QDR?.....
2. 在濕式清洗或蝕刻製程中, QDR 之用途為何?.....
3. 執行一次晶圓沖洗流程 (實作).....

※ Spin dryer 流程操作

1. 在後段製程區中, 如何執行晶圓乾燥製程?.....

2. 說明以 Spin dryer 乾燥晶圓之動作原理並說明其中靜電消除裝置之用途.....
 3. 說明 Rinse Mode 與 Dry Mode 之使用時機.....
 4. Spin dryer 流程操作（實作）？.....
- ※ 化學品供應系統及小瓶化學品之使用與處置
1. 廠務負責化學品中央供應系統負責工程師？.....
 2. 在後段製程區 Wet Bench 中，僅由中央供應系統哪幾種化學藥品？.....
- ※ 機台使用前、後之確認
- 機台使用前之確認
1. 機台燈號顯示之辨認（綠燈：正常運轉中；紅燈：故障維修中）.....
 2. 檢查使用記錄表（可得知每一化學槽之狀況）.....
- 機台使用後之確認
1. 進行使用後之紀錄.....
 2. 如遇機台異常狀況要填寫何種表單？.....